



プレスリリース

2020年3月4日

EV Group、ヘテロジニアス・インテグレーション・コンピテンスセンターを設立 ヘテロ集積化と先端パッケージングにより新製品開発の加速を支援

ウェーハ接合およびリソグラフィ装置のリーディングサプライヤーである EV Group (本社: オーストリア ザンクト・フローリアン、以下: EVG) は、ヘテロジニアス・インテグレーション (HI)・コンピテンスセンターを設立したことを発表いたしました。この施設は、お客様が EVG のプロセスソリューションおよびノウハウを活用できるよう設計され、システムインテグレーションとパッケージング技術の進歩によって加速する新製品やアプリケーション開発を支援いたします。これらには、高性能計算やデータセンター、IoT (Internet of Things)、自動運転、医療およびウェアラブルデバイス、フォトニクス、先端センサー等に対するソリューションおよびアプリケーションが含まれます。

HI コンピテンスセンターでは、世界中で実績のある EVG のウェーハ接合装置・薄ウェーハ搬送向け装置・リソグラフィ装置および各種プロセスノウハウの他、EVG オーストリア本社内の最先端クリーンルームに設置した試作製造ラインとサービス、およびプロセステクノロジーチームによるグローバルサポートが利用できます。EVG は HI コンピテンスセンターを通じて、ヘテロ集積化と先端パッケージングを用いて技術開発を加速し、最小限のリスクでお客様の技術および製品の差別化を図ることをお手伝いするとともに、商品化前の製品開発に必要とされる知的財産権の保護を最高水準で保証いたします。

EVG の知的財産・技術開発本部のディレクターを務める Markus Wimplinger は、以下のように述べています。「ヘテロ集積化は、新たなパッケージング形態と新規製造技術を促進し、より優れたシステムと柔軟なデザインが可能となるとともに、性能の向上とシステム設計コストの削減も可能となります。この度 EVG が設立した HI コンピテンスセンターは、お客様やマイクロエレクトロニクスのサプライチェーンを通じて協業するパートナー企業様へ、オープンアクセスなイノベーション・インキュベーターを提供します。そして、私たちが持つソリューションとプロセス技術のリソースを活用することで、ヘテロ集積化によって可能となる革新的なデバイスやアプリケーションの開発サイクルと市場への投入時間の短縮を実現します」

EVG はヘテロ集積化に関して広範囲に渡る要素技術を有しており、この重要な技術トレンドに対するソリューションを 20 年以上提供し続けています。これには、永久ウェーハ接合 (3D パッケージング向けフュージョン/ハイブリッド接合や金属接合を含む) や、ダイ to ウェーハ接合 (一括転写用支持基板あり・なし) による III-V 族化合物半導体-シリコンの統合あるいは高密度 3D パッケージング、仮接合・剥離技術 (機械式・スライドオフ/リフトオフ・UV レーザー剥離を含む)、薄ウェーハ搬送、革新的なリソグラフィ技術 (マスクアライナー、コーター、ディベロッパー、マスクレス露光/デジタルリソグラフィ等) などがあります。

先端パッケージングにおけるマイルストーン

20 年以上前、EVG は特許技術 SmartView® を搭載したウェーハ to ウェーハアライメント装置によって永久接合の分野を開拓し、この技術を長年改良し続けることで、裏面照射型 CMOS イメージセンサー (BSI-CIS) のような革新的技術の開発に貢献してきました。また近年、ウェーハ to ウェーハアライメントで 100 nm 以下のオーバーレイ精度をハイブリッド接合で初めて実証し、これにより 3D BSI-CIS やメモリ・オン・ロジック積層といったデバイスの開発が可能になりました。さらに 2001 年、3D/積層ダイパッケージングに不可欠な極薄ウェーハ向けに仮接合装置を初めて開発するとともに、極薄積層ファンアウトパッケージ向けに革新的な低温レーザー剥離装置を発表しました。



一方リソグラフィの分野において、EVGは10年以上前にウェーハレベル・オプティクス[®]の量産向けに世界初のUVモールドニング・ソリューションを提供し、技術リーダーとしての地位を確固なものとなりました。以来、EVGはナノインプリント・リソグラフィ(NIL)技術の量産適用を主導しています。また、EVGは先端パッケージング向けマスクアライメント・リソグラフィにおいて処理速度およびアライメント精度の限界を更新し続けている他、最近では拡張性に優れた世界初のマスクレス露光技術を発表し、量産向けバックエンドリソグラフィにおける新たな要件に対応しています。

EVGのヘテロジニアス・インテグレーション・コンピテンスセンターの詳細については、下記ウェブサイトをご覧ください(<https://www.evgroup.com/services/>)。

当センターへの参加に関心のある企業様は、下記よりEVGにご連絡ください。

TEL: +43 7712 5311 0 / E-mail: HeterogeneousIntegration@EVGroup.com

EV GROUP(EVG)について

EV Group(EVG)は半導体、MEMS、化合物半導体、パワーデバイスおよびナノテクノロジーデバイスの製造装置およびプロセスソリューションのリーディングサプライヤーです。主要製品には、ウェーハ接合、薄ウェーハプロセス、リソグラフィ/ナノインプリント・リソグラフィ(NIL)や計測機器だけでなく、フォトレジストコーター、クリーナー、検査装置などがあります。1980年に設立されたEVGは、グローバルなお客様および世界中のパートナーに対し緻密なネットワークでサービスとサポートを提供します。EVGに関する詳しい情報は www.EVGroup.com をご参照ください。

プレスの方の問い合わせ先

イーヴィグループジャパン株式会社 マーケティング担当

TEL: 045-348-0665 E-mail: Marketing+CommunicationsJapan@EVGroup.com

ミアキス・アソシエイツ 河西

TEL: 090-4376-0123 E-mail: kasai@miacis.com

###